

Отрасль оборудования для полупроводникового производства

Тенденции, тренды и лидеры в индустрии

Уважаемый клиент,

В настоящем обзоре мы рассматриваем текущее состояние и перспективы отрасли оборудования для производства полупроводниковых чипов — ключевого звена мировой технологической инфраструктуры. Данная индустрия, объединяющая поставщиков оборудования для литографии, травления, осаждения, тестирования и упаковки микросхем, представляет собой фундамент всей полупроводниковой экосистемы и мирового технологического производства. По данным Goldman Sachs, совокупный объем рынка оборудования для фабрики пластин (Wafer Fab Equipment, WFE) в 2025 году оценивается на уровне около \$100 млрд, что соответствует умеренному росту на фоне стабилизации капитальных расходов крупнейших производителей чипов. Несмотря на окончание периода ациклического роста 2021–2022 годов, спрос на передовое оборудование остается устойчивым благодаря переходу к новым архитектурам, связанным с развитием искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и интеграции 3D штабелирования¹ в производство памяти.

В основе текущего цикла лежит не просто увеличение количества покупаемого оборудования, но и принципиальное усложнение технологических процессов, делающих это оборудование еще дороже. Ключевые заказчики, включая TSMC, Samsung, SK Hynix, Micron и Intel, продолжают инвестировать в оборудование, необходимое для освоения узлов 3 нм и ниже, где увеличивается число этапов осаждения и травления, а требования к точности процессов становятся предельно высокими. Одновременно наблюдается рост интереса к передовым методам упаковки и интеграции памяти по типу High Bandwidth Memory, которые становятся основой архитектур для обучения и само-улучшения больших языковых моделей. В совокупности эти факторы создают благоприятные условия для дальнейшего роста выручки крупнейших производителей оборудования, а именно ASML, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron, KLA и ASM International.

С Уважением,
Команда Департамента Торговых Идей



¹ 3D IC packaging — это процесс создания интегрированных схем, где чипы «накладываются» друг на друга по вертикали, вместо того чтобы делать каждый чип отдельно.

Оглавление

Введение	2
Наше мнение.....	4
Описание отрасли – высокая концентрация, барьеры входа и роль ключевых компаний.....	4
Тренд 1: Рост капитальных затрат и циклические особенности.....	5
Тренд 2: Технологические тренды и переход на новые архитектуры.	5
Тренд 3: Геополитика и Китайский фактор.	6
Заключение.	6
Список ключевых компаний в подотрасли	7
ASML Holding N.V. (ASML)	7
Applied Materials (AMAT)	7
Lam Research Corporation (LRCX)	8
Tokyo Electron Limited (TEL).....	8
KLA Corporation (KLAC)	9

Обзор отрасли оборудования для производства полупроводников

Наше мнение

Мы оцениваем подотрасль оборудования для производства полупроводников как находящуюся в фазе умеренного, но устойчивого роста, переходящей из фазы массовой продажи литографического оборудования в период, когда ключевую роль начинают играть процессы травления, осаждения и упаковки. Несмотря на то, что глобальный полупроводниковый цикл в целом демонстрирует признаки нормализации, сегмент оборудования сохраняет структурную силу благодаря совокупности технологических и инвестиционных факторов. Ведущие аналитики Goldman Sachs указывают, что темпы роста мирового рынка оборудования в 2025 году составят около 5%, а в 2026 году сохранятся в положительной зоне около 2%, что подтверждает устойчивость сектора в условиях макроэкономической неопределенности.

Спрос на оборудование остается высоким из-за того, что новые производственные технологии требуют все большего объема инвестиций, а также растущего количества технологических стадий и более дорогих установок на каждый узел. Среднегодовой темп роста капитальных затрат полупроводниковой индустрии (CapEx CAGR) оценивается Goldman Sachs на уровне около 6.5% до 2027 года, при этом совокупный рынок полупроводникового производственного оборудования растет приблизительно на 4.3% в год. В отличие от прежних циклов, характеризующихся выраженными колебаниями, текущая фаза отличается большей стабильностью, поскольку развитие новых архитектур стимулирует постоянный спрос на модернизацию производственных линий.

Мы считаем, что структура спроса в ближайшие годы будет определяться расширением производственных программ у TSMC и Samsung, модернизацией NAND и DRAM линий, а также формированием устойчивого сегмента внутренних китайских инвестиций. Среди бенефициаров структурного перехода выделяются Lam Research и Applied Materials, которые доминируют в производстве систем травления и осаждения и обеспечивают критические технологические решения для интеграции 3D чипов, HBM и архитектуры Backside Power Delivery.

Описание отрасли – высокая концентрация, барьеры входа и роль ключевых компаний.

Рынок оборудования для производства полупроводников отличается исключительной степенью концентрации и технологической закрытостью, что практически исключает возможность появления новых игроков. Пять крупнейших компаний — ASML, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron и KLA — контролируют свыше трех четвертей мировых поставок WFE²-оборудования, при этом каждая из них занимает фактически монопольную позицию в собственном технологическом сегменте. ASML остается единственным производителем EUV-литографических³ систем, без которых невозможен выпуск чипов на узлах 7 нм и ниже; Applied Materials доминирует в процессах осаждения⁴, травления⁵ и продвинутой упаковки⁶, обеспечивая критические этапы формирования многослойных структур; Lam Research специализируется на dry-etch (подтип травления) процессах и оборудовании для NAND⁷ и HBM⁸, оставаясь ключевым поставщиком для производителей памяти; KLA фактически определяет стандарты качества в сфере «контроля процессов»⁹ и метрологии¹⁰, без ее систем невозможен контроль дефектов на передовых техпроцессах; Tokyo Electron играет важнейшую роль в областях нанесения фоторезиста, очистки и формирования тонких слоев материала, обеспечивая устойчивость производственной экосистемы в Азии.

Высокая степень технологической сложности приводит к тому, что разработка новых установок требует многомиллиардных вложений и длительных циклов научных исследований, а стоимость создания

² WFE (wafer fabrication equipment) – оборудование для производства полупроводников на кремниевых пластинах.

³ Литография – процесс, в котором нужный рисунок микросхемы «отпечатавают» на пластине с помощью лазера.

⁴ Осаждение (deposition) – это процесс нанесения определенного вещества на кремниевую пластину.

⁵ Травление (etching) – это процесс «вырезания», где слой материала на пластине химически убирается в нужных местах, где защитный материал, нанесенный во время осаждения, был убран во время литографии.

⁶ Продвинутая упаковка (advanced packaging) – это способ соединения нескольких чипов в одно микро-устройство перед как его замуровывают в корпус.

⁷ NAND – тип памяти твердотельных накопителей для хранения данных

⁸ HBM (high bandwidth memory) – подтип оперативной памяти с повышенной пропускной способностью

⁹ Контроль качества работы процессов производства и оптимизации его процессов.

¹⁰ Метрология – процесс наблюдения за микроскопическими структурами.

конкурентоспособного решения в сегменте EUV, ALD или передовых dry-etch систем может превышать два миллиарда долларов. Полный процесс вывода установки на рынок может занимать шесть–семь лет, включая фундаментальные исследования, инженерную разработку и промышленную квалификацию. Эти масштабы затрат усиливают технологические барьеры, закрепляя лидерство действующих компаний и минимизируя вероятность появления новых поставщиков. Фактически каждая инновация — будь то переход на Gate-All-Around, Backside Power Delivery, многослойную 3D-память или архитектуры High-NA EUV — только повышает капиталоемкость отрасли и делает технологический барьер непреодолимым для новых игроков.

На фоне столь высокой концентрации роль ключевых компаний отрасли становится системообразующей для всей мировой полупроводниковой экосистемы. ASML остается безусловным лидером литографического сегмента и в 2025 году выводит на рынок установки High-NA EUV, увеличивающие технологический разрыв между ней и потенциальными конкурентами на десятилетия вперед. Applied Materials использует преимущества роста числа стадий осаждения и травления, а также становится ключевым бенефициаром внедрения архитектур GAA и BPD, определяющих структуру производственных процессов будущего. Lam Research укрепляет доминирование в dry-etch технологиях, обеспечивая критические операции при производстве HBM и более чем 200-слойных NAND-структур, что делает ее главным поставщиком для Samsung, SK Hynix и Micron. KLA сохраняет статус «невидимого монополиста», контролируя сегмент инспекции и метрологии и извлекая устойчивую выручку из сервисных контрактов, крайне чувствительных для выхода кристаллов пригодных для дальнейшего использования. Tokyo Electron усиливает позиции в Азии благодаря тесному взаимодействию с TSMC и Samsung, а ASM International расширяет влияние в нише атомарного осаждения, обеспечивая критические технологические решения для транзисторов следующего поколения.

Таким образом, концентрация отрасли и роль ключевых компаний не просто отражают текущую структуру рынка, но и определяют долгосрочные перспективы развития полупроводниковой индустрии. Технологическая сложность, капиталоемкость и уникальность оборудования устанавливают устойчивый контроль пяти крупнейших компаний над отраслью, в которой каждый ведущий игрок выполняет незаменимую функцию, а совокупность их технологий формирует ядро глобальной производственной цепочки.

Тренд 1: Рост капитальных затрат и циклические особенности.

После периода перегрева и рекордных инвестиций 2021–2022 годов рынок оборудования вступил в фазу нормализации, характеризующуюся снижением темпов роста, но сохранением высокого базового уровня спроса. В 2023 году мировой рынок полупроводников сократился примерно на 8%, что отразилось на заказах оборудования для их производства, однако уже в 2024 году началось восстановление за счет активизации китайских инвестиций, которые выросли на 46% и компенсировали снижение заказов в других регионах. В 2025 году наблюдается умеренное увеличение капитальных затрат вне Китая на 5–6%, что отражает плавный выход из спада и формирование новой фазы инвестиционного цикла.

Структура капитальных расходов смещается в сторону расширения производственных мощностей для передовых логических и памяти-ориентированных узлов. На долю фабрик типа «foundry» приходится около 42% совокупных инвестиций, преимущественно благодаря программам TSMC, Samsung и Intel. Сегмент DRAM¹¹ формирует около 24% мировых капитальных затрат, основным драйвером которого выступает растущий спрос на HBM, необходимую для ИИ-систем. Вклад NAND остается на уровне около 13%, но в 2025 году здесь ожидается рост инвестиций почти на 50% по сравнению с предыдущим годом благодаря запуску более чем 200-слойных ячеечных структур. Остальные категории, включая логические и специализированные узлы, обеспечивают порядка 20% объема капитальных затрат.

Интенсивность инвестиций (отношение WFE к совокупной выручке отрасли) возвращается к долгосрочному среднему уровню 15%, что свидетельствует о нормализации после экстремально высоких показателей 2023 года, когда доля достигала 18% и впоследствии упала ниже средне исторических величин. Таким образом, отрасль находится в устойчивом положении, характеризующемся сбалансированным спросом, умеренным ростом и отсутствием признаков глубокого циклического спада.

Тренд 2: Технологические тренды и переход на новые архитектуры.

Современная технологическая эволюция полупроводниковой индустрии формирует новые инвестиционные приоритеты для производителей оборудования. Наиболее значимым направлением является переход на транзисторную архитектуру Gate-All-Around (GAA), которая в сочетании с технологией Backside Power Delivery

¹¹ DRAM – оперативная память компьютера

(BPD) обеспечивает дальнейшее снижение энергопотребления и повышение производительности чипов. Эти инновации требуют радикального увеличения числа стадий осаждения и травления, что ведет к росту потребности в оборудовании Lam Research и Applied Materials. Goldman Sachs отмечает, что внедрение GAA и BPD увеличивает адресуемый рынок «материалов и проводящих слоев» примерно на 15% на каждые сто тысяч пластин, что создает мощный структурный драйвер для производителей осадочных и травильных систем.

Другим ключевым направлением становится развитие продвинутых технологий «упаковки» (advanced packaging), где процесс соединения кристаллов становится не менее важным, чем литография. Применение решений CoWoS¹², 3D-IC¹³ и TSV¹⁴ делает «упаковку» критическим звеном производительности ИИ-чипов. По оценкам Goldman Sachs, в 2024 году объем рынка упаковочного оборудования достиг \$9–10 млрд против \$3–4 млрд в 2020 году, а Applied Materials уже получает около \$1.7 млрд выручки из этого сегмента.

Отдельно стоит выделить сегмент памяти высокой пропускной способности (HBM), где переход к многоуровневым стек-структурам требует дополнительных стадий обработки и более сложных процессов травления. До 75% технологических операций в производстве HBM обеспечиваются решениями Applied Materials и Lam Research, что делает эти компании главными бенефициарами роста данного направления. Восстановление сегмента NAND также поддерживает спрос на оборудование, поскольку переход к вертикально интегрированным ячейкам требует модернизации линий под 200- и более слойные структуры. В совокупности технологические сдвиги усиливают «etch/deposition-интенсивность» процессов, постепенно снижая удельный вес литографии и увеличивая стратегическую значимость материаловедческих операций.

Тренд 3: Геополитика и Китайский фактор.

Китай сохраняет роль крупнейшего регионального рынка оборудования для производства чипов, хотя его доля в глобальных поставках постепенно снижается. Если в 2024 году на Китай приходилось до 40% всех закупок WFE, то в 2025–2026 годах этот показатель, по оценке Goldman Sachs, опустится до 25–30% в связи с усилением экспортных ограничений США. Однако аналитики отмечают, что большая часть китайских закупок в предыдущие годы имела не спекулятивный «про запас», а стратегический характер: оборудование приобреталось не только для складирования, но и в рамках программ технологического суверенитета, нацеленных на развитие собственных цепочек поставок в сферах электроники, телекоммуникаций и электромобилей. Данные потребности говорят в пользу стабильности будущей выручки благодаря наличию системного спроса от Китайских компаний на не-санкционное оборудование.

Китайские производители оборудования, такие как NAURA, AMEC и ACM Research, увеличили совокупную долю на глобальном рынке с одного процента в 2014 году до примерно пяти процентов в 2024 году, однако их технологические возможности пока ограничены устаревшими техпроцессами и не конкурируют с передовыми решениями из США, Нидерландов и Японии. При этом три крупнейших американских поставщика — Applied Materials, Lam Research и KLA — сохраняют около 70% совокупной доли мирового рынка WFE, что демонстрирует устойчивость их технологического лидерства. В целом Китай остается не угрозой, а скорее возможностью для глобальных компаний из отрасли, поскольку его внутренний спрос продолжает расти, а ограничения пока не распространяются на устаревшие узлы (28 нм и выше¹⁵), где возможна кооперация между местными и иностранными компаниями.

Заключение.

Подотрасль оборудования для производства полупроводниковых чипов является ядром всей мировой технологической инфраструктуры. После бурного роста в 2021–2022 годах и периода нормализации в 2023–2024 годах рынок вошел в фазу устойчивого сбалансированного развития. Ключевые драйверы — переход на архитектуры нового поколения, рост капиталоемкости производственных процессов, развитие искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений — формируют долгосрочный спрос на продукцию ведущих компаний отрасли. В то время как геополитические факторы и торговые ограничения создают отдельные риски, технологическая сложность и ограниченность предложения оборудования обеспечивают производителям устойчивые позиции и высокие барьеры конкуренции.

¹² CoWoS (chip on wafer on substrate) или же «2.5D-упаковка» - это подход TSMC к интеграции чипов друг на друге.

¹³ 3D IC — это подтип интегрированных схем, где чипы «накладываются» друг на друга по вертикали, а не рядом друг с другом по горизонтали как это принято в традиционных схемах. Данные IC меньше размером, эффективнее, но и сложнее в производстве.

¹⁴ TSV — это метод соединения между собой разных «слоев» интегрированной схемы.

¹⁵ Следует пояснить что классификация техпроцессов по нанометрам связана с фактом улучшения возможностей полупроводников в зависимости от размера каждого транзистора, в нанометрах, а следственно их количества и более высокой плотности на чипе одинакового размера. Другими словами: меньше размер — выше качество/сложность чипа.

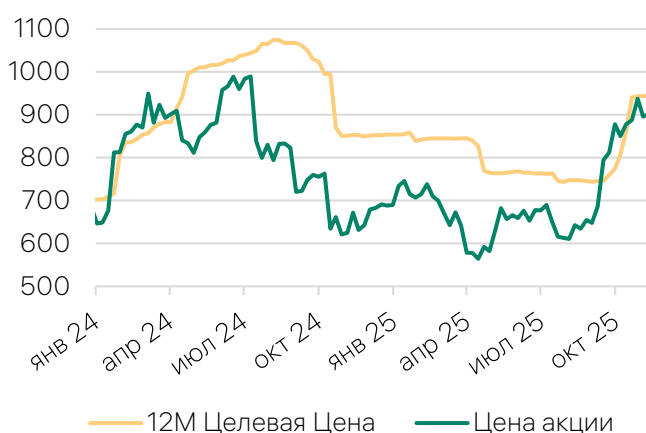
Мы считаем, что подотрасль оборудования для производства полупроводников сохраняет статус стратегически важного сегмента, обеспечивающего технологическую независимость и инновационный прогресс мировых экономик. На горизонте 2025–2030 годов именно компании ASML, Applied Materials и Lam Research, опирающиеся на уникальные технологические компетенции и долгосрочные контракты с крупнейшими чипмейкерами, наиболее вероятно останутся главными бенефициарами цифровой трансформации и глобального роста спроса на вычислительные мощности.

Список ключевых компаний в подотрасли

ASML Holding N.V. (ASML)

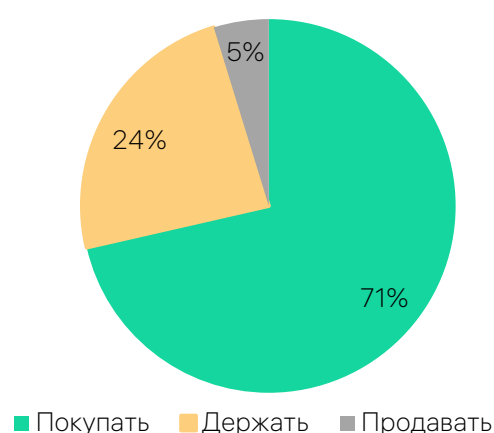
Крупнейшая европейская технологическая компания и абсолютный мировой лидер в области литографического оборудования для производства полупроводников, играющая ключевую роль в обеспечении технологического прогресса на узлах 7 нм и ниже. В 2025 году ASML остается единственным поставщиком EUV-систем, без которых невозможен выпуск чипов для высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и серверных архитектур нового поколения. Компания обеспечивает устойчивость глобальной полупроводниковой цепочки, поставляя оборудование TSMC, Samsung и Intel, а запуск установок High-NA EUV фактически открывает новую технологическую эпоху, расширяя возможности масштабирования по закону Мура¹⁶. Развитие EUV-экосистемы требует тесной кооперации с Японией, США и Тайванем, а также сложной многоуровневой логистики, что укрепляет стратегическое значение ASML в мире, где технологический суверенитет становится критически важным фактором национальной безопасности. Помимо литографии компания активно развивает сервисный бизнес, обеспечивая модернизацию парка оборудования на протяжении всего жизненного цикла. Благодаря уникальности технологий и исключительной рыночной позиции ASML сохраняет статус критического звена мировой полупроводниковой индустрии, что обеспечивает компании высокий уровень заказов и устойчивый рост в долгосрочной перспективе.

График 2: Движение цены АДР ASML с 2024 г.



Источник: Bloomberg

График 3: Рекомендации аналитиков



Источник: Bloomberg

71% аналитиков рекомендуют акции к покупке.

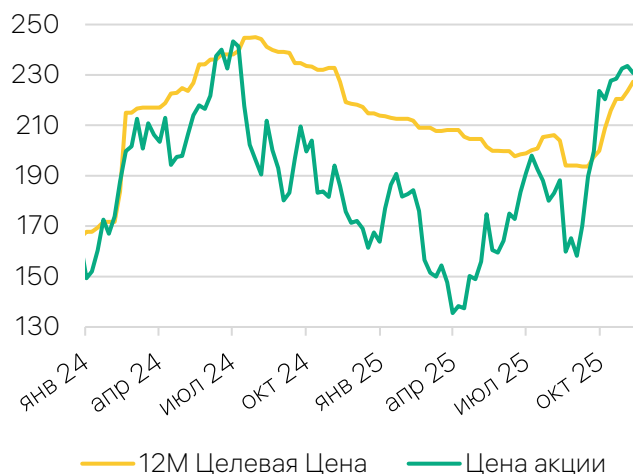
Applied Materials (AMAT)

Крупнейший мировой производитель оборудования для травления, осаждения, материаловедения и продвинутой упаковки, играющий центральную роль в переходе к транзисторным архитектурам Gate-All-Around и технологиям Backside Power Delivery. Applied Materials обеспечивает основу для большинства ключевых процессов современной литографии, создавая решения, которые определяют физические свойства слоев на передовых узлах. В 2025 году компания особенно укрепляет позиции в сегменте advanced packaging, где ее технологии CoWoS и 3D-IC становятся стандартом для производства ИИ-чипов. Applied Materials обеспечивает совокупно более половины всех операций, связанных с формированием HBM-структур, необходимых для высокопроизводительных систем Nvidia, AMD и Huawei. Рост капиталоемкости техпроцессов и увеличение числа стадий осаждения и травления создают для компании масштабное структурное преимущество. Благодаря глобальному охвату, многоуровневой экосистеме сервисов и сотрудничеству с ведущими «foundry» производителями и поставщиками памяти, Applied Materials остается одним из ключевых участников

¹⁶ Закон Мура – эмпирическое наблюдение согласно которому количество транзисторов на кристалле интегральной схемы удваивается каждые 24 месяца. Таким образом, самые совершенные чипы становятся в два раза сложнее в производстве, но и пропорционально производительнее каждые 2 года.

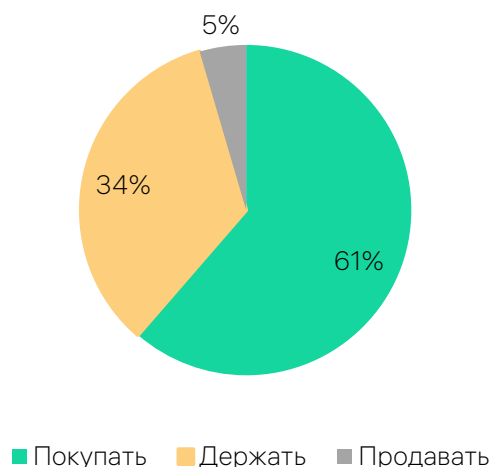
технологического прогресса и одним из самых важных бенефициаров роста спроса на вычислительные мощности.

График 6: Движение цены Applied Materials (AMAT) с 2024 г.



Источник: Bloomberg

График 7: Рекомендации аналитиков



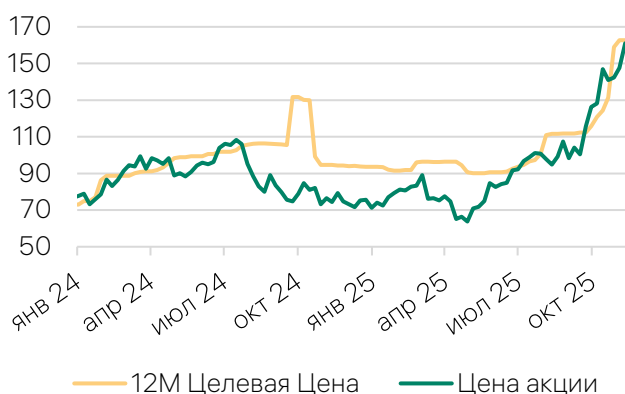
Источник: Bloomberg

61% аналитиков рекомендуют акции к покупке.

Lam Research Corporation (LRCX)

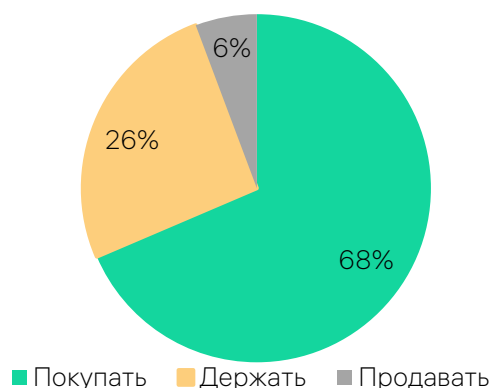
Одно из ведущих предприятий американской полупроводниковой индустрии, специализирующееся на оборудовании для сухого травления и осаждения — двух наиболее сложных и критически важных стадиях современного техпроцесса. Lam Research обеспечивает технологическую основу для производства NAND и DRAM, а также для формирования многоуровневых стековых структур HBM, необходимых для высокоскоростной памяти в ИИ-системах. Компания является крупнейшим поставщиком оборудования для модернизации NAND-линий при переходе к >200-слойным архитектурам, что делает ее главным бенефициаром восстановления рынка памяти. В областях GAA и BPD Lam Research предоставляет решения, обеспечивающие точность формирования транзисторных каналов и изоляционных слоев, что становится критически важным для масштабирования технологий на узлах 3 нм и ниже. Комплексность оборудования и высокая стоимость R&D создают прочные барьеры для конкурентов, а высокий уровень выручки от услуг обеспечивает устойчивую маржинальность. Lam Research остается ключевым поставщиком для Samsung, SK Hynix, Micron и TSMC, что укрепляет ее положение в глобальной цепочке поставок и делает стратегическим активом для всей индустрии.

График 4: Движение цены LAM Research (LRCX) с 2024 г.



Источник: Bloomberg

График 5: Рекомендации аналитиков



Источник: Bloomberg

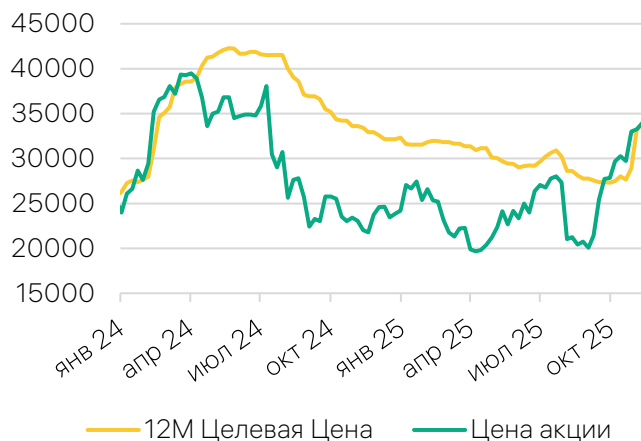
68% аналитиков рекомендуют акции к покупке.

Tokyo Electron Limited (TEL)

Ведущий японский производитель полупроводникового оборудования и один из крупнейших поставщиков технологических решений для нанесения фоторезиста, тонкопленочного осаждения и очистки пластин. Tokyo Electron занимает ключевую роль в азиатской производственной экосистеме, обеспечивая поставки оборудования для TSMC, Samsung и японских производителей памяти. Компания активно участвует в переходе к архитектурам GAA, разрабатывая оборудование для сверхточного формирования слоев, необходимых в транзисторных структурах нового поколения. Сильная интеграция TEL в цепочки поставок Японии — страны,

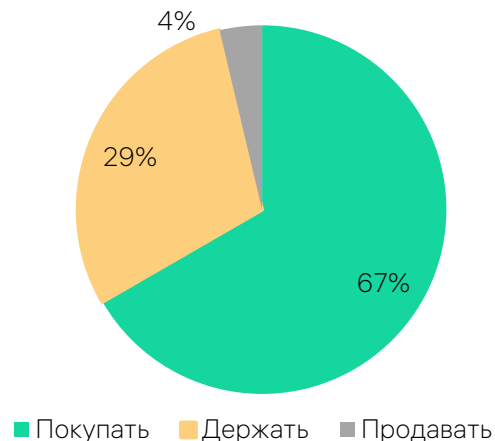
контролирующей значительную часть мирового рынка материалов и компонентов — делает ее незаменимым игроком в мировой индустрии. Tokyo Electron активно расширяет присутствие в нише deposition/cleaning, где растущая сложность техпроцесса приводит к увеличению числа операций на каждый узел. Благодаря высокой технологичности, широкой продуктовой линейке и ключевой роли в азиатских производственных цепочках компания сохраняет стратегический статус и демонстрирует устойчивый рост спроса на свою продукцию.

График 8: Движение цены Tokyo Electron (TYO:8035) с 2024 г.



Источник: Bloomberg

График 9: Рекомендации аналитиков



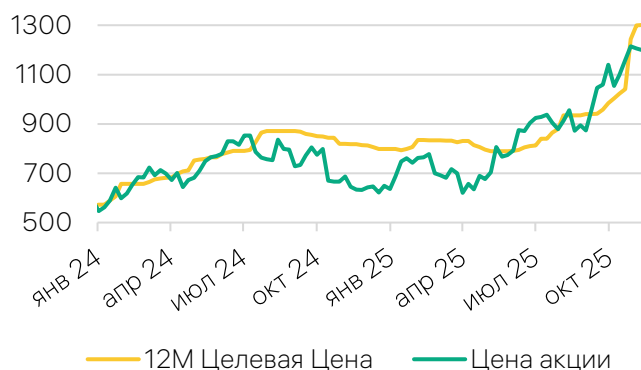
Источник: Bloomberg

67% аналитиков рекомендуют акции к покупке.

KLA Corporation (KLAC)

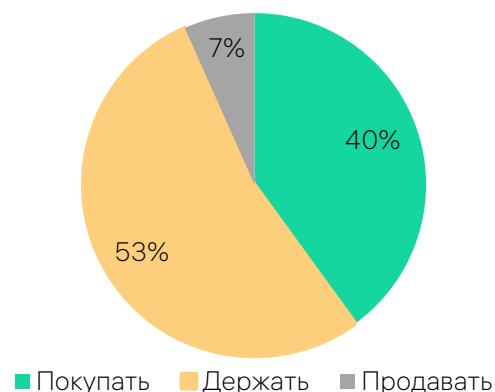
Глобальный лидер в области систем контроля, метрологии и выявления дефектов, обеспечивающий фундаментальную основу качества в полупроводниковом производстве. Компания доминирует в сегменте process control, который становится все более критичным по мере усложнения архитектур и уменьшения размеров транзисторов. KLA обеспечивает производителям чипов возможность выявлять дефекты на ранних стадиях, сокращая издержки и оптимизируя выход приемлемых к использованию кристаллов. В 2025 году роль KLA усиливается на фоне роста числа этапов осаждения и травления: чем сложнее производственный процесс, тем выше значимость контроля качества на каждом шаге. Высокая капитализация сервисного бизнеса, составляющего более трети выручки, обеспечивает устойчивость финансового профиля. Комплексность технологий и необходимость глубоких исследований формируют чрезвычайно высокие барьеры для конкурентов, что закрепляет за KLA статус «невидимого монополиста» в одном из важнейших сегментов мирового полупроводникового производства. Компания остается незаменимым поставщиком для ASML, TSMC, Intel, Samsung, Micron и других ключевых игроков индустрии, что обеспечивает ей долгосрочную устойчивость и стратегическую значимость в глобальной технологической экосистеме.

График 10: Движение цены KLA Corp (KLAC) с 2024 г.



Источник: Bloomberg

График 11: Рекомендации аналитиков



Источник: Bloomberg

40% аналитиков рекомендуют акции к покупке.

Приложение 1. Ключевые финансовые показатели компаний, упомянутых в данном отчете

Компания	Тикер	Капит., млрд \$	P/E	Forw. P/E	PEG	EV/ EBITDA	P/B	P/S	ROE	ROA	Бета	Изм. цены с начала 2024 года	Див. Доход-ть
ASML	ASML NA Equity	366.7	39.0	36.0	1.7	26.0	19.3	11.5	53.9%	21.8%	1.83	2.65	-
LAM Research	LRCX US Equity	211.9	37.4	29.9	2.3	19.2	20.8	11.0	0.6	28.0%	1.72	-33.1%	-
Applied Materials	AMAT US Equity	215.2	28.9	23.8	2.8	20.2	10.5	7.7	35.5%	19.8%	1.56	-42.5%	0.64
KLA Corp	KLAC US Equity	163.7	35.8	29.5	3.0	21.1	32.9	13.2	99.2%	26.5%	1.65	493.4%	0.58
Tokyo Electron	8035 JT Equity	95.3	26.7	25.1	3.9	11.5	7.2	5.8	28.5%	20.9%	1.31	29.3%	-

АО «Halyk Finance», дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана». Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением или попыткой со стороны АО «Halyk Finance» купить, продать или вступить в иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и иных финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка, предоставить какие-либо инвестиционные рекомендации или услуги. Указанные предложения могут быть направлены исключительно в соответствии с требованиями применимого законодательства. Настоящая публикация основана на информации, которую мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. Мы не несем ответственности за использование клиентами информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за сделки и операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, упоминающимися в ней. Мы не берем на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящей публикации или исправлять возможные неточности. Инвестиции в активы на финансовых рынках имеют высокую степень риска. При этом прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем. Также отмечаем, что на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, рассматриваемые в настоящей публикации и номинированные в иностранной валюте, могут оказывать влияние обменные курсы валют. Изменение обменных курсов валют может вызвать снижение стоимости инвестиций в указанные активы. Следует иметь в виду, что инвестирование в депозитарные расписки также подвержено риску изменения обменного курса валют. Инвесторы до принятия решения об участии в сделках с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, рассматриваемыми в настоящей публикации, должны проводить собственное исследование относительно надежности эмитентов данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО «Halyk Finance».

© 2025 г., все права защищены.

Департамент торговых идей

E-mail
dti@halykfinance.kz

Департамент продаж

E-mail
sales@halykfinance.kz

Адрес:
Halyk Finance
пр. Абая, 109 «В», 5 этаж
A05A1B9, Алматы, Республика Казахстан
Тел. +7 727 331 59 77
www.halykfinance.kz

Bloomberg
HLFN
Refinitiv
Halyk Finance
Factset
Halyk Finance
Capital IQ
Halyk Finance